

电子

行业研究/周报

三季度报陆续披露，高增长逻辑再次兑现

—电子周报 20211018

电子周报

2021年10月18日

报告摘要:

● 市场整体上涨，半导体上涨3.57%

上周(2021/10/11-2021/10/15)市场整体上涨，半导体指数上涨3.57%。其中：半导体设计-0.1%、半导体制造-1.3%、半导体封测4.9%、半导体材料0.7%、半导体设备0.8%、功率半导体7.3%。上周费城半导体指数上涨，涨幅为2.10%，台湾半导体指数上周上涨2.54%，截至上周(2021/10/15)，A股半导体公司总市值达31,161亿元，环比+0.8%，对应2021年整体PE为58.20倍。

● 三季度业绩公告及三季度预告

1) **设计-MCU**: 受益高景气度+国产替代，MCU标的业绩高增长。其中国民技术Q3单季扣非归母0.43亿，成功扭亏为盈；中颖电子预计Q3单季度归母净利润1.10-1.18亿元，同比增加96%-109%。未披露公司中，兆易创新Q3产能较Q2继续增长，我们认为业绩高增长确定性强。

2) **设计-模拟**: 圣邦股份预计Q3单季度归母净利润1.6亿元—2.0亿元，同比+60%—95%。

3) **设计-其他**: 预计实现扣非净利润28.1-32.1亿元，同比+77.52-102.74%。

4) **设备**: 持续受益于国内产线扩产。晶盛机电预计Q3单季度归母净利润4.7-5.8亿元，同比增长91%-134%。

5) **封测**: 高景气持续，封测厂产线持续满载。通富微电预计Q3单季实现净利润2.8-3.2亿元，同比+85.66-112.26%。

5) **材料**: 半导体材料公司21Q3单季归母净利润同比增速基本位于70%-270%区间，其中立昂微同增195%-268%领跑材料行业。

6) **功率**: 功率半导体公司21Q3单季归母净利润同比增速位于80%-200%区间，其中苏州固锟同增148%-187%领跑功率板块。

● 投资建议

持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业：韦尔股份、兆易创新、斯达半导体、中车时代电气、芯源微。

● 风险提示

下游代工厂扩产进度可能不及预期、国内厂商先进技术发展可能不及预期、行业景气度持续不及预期。

盈利预测与财务指标

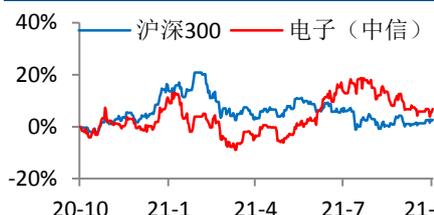
代码	重点公司	现价 10月15日	EPS			PE			评级
			2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	
603501	韦尔股份	250	3.11	5.19	7.36	80	48	34	推荐
603986	兆易创新	156	1.32	2.92	4.21	118	53	37	推荐
603290	斯达半导	413	1.13	2.18	3.03	366	190	136	推荐
3898	中车时代电气	37	2.08	2.20	2.50	18	17	15	NA
688037	芯源微	203	0.58	1.10	1.99	350	186	102	推荐

资料来源：公司公告、民生证券研究院

推荐

维持评级

行业与沪深300走势比较



资料来源：Wind，民生证券研究院

分析师：王芳

执业证号：S0100519090004

电话：021-60876730

邮箱：wangfang@mszq.com

分析师：杨旭

执业证号：S0100521050001

电话：021-60876730

邮箱：yangxu_yj@mszq.com

分析师：王浩然

执业证号：S0100521040001

电话：021-60876730

邮箱：wanghaoran@mszq.com

研究助理：赵晗泥

执业证号：S0100120070021

电话：021-60876730

邮箱：zhaohanni@mszq.com

相关研究

- 【民生电子】汽车电子月报：新势力9月销量破万，智能化升级加速
 - 【民生电子】半导体周跟踪：硅片涨价与扩产并进，功率半导体高景气持续
- 20211011

目录

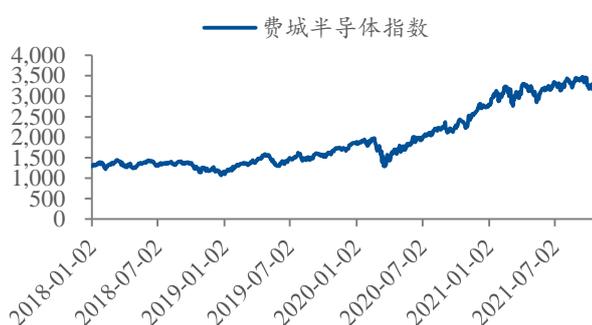
1	行情回顾：市场整体上涨，半导体上涨 3.57%.....	3
2	行业新闻	7
3	三季报披露情况	9
3.1	设计	9
3.2	设备	11
3.3	封测	11
3.4	材料	12
3.5	功率	13
4	本周重点报告：雅克科技——稀缺与成长兼备，半导体材料平台龙头正起航.....	14
5	投资建议	14
6	风险提示	16
	插图目录	17

1 行情回顾：市场整体上涨，半导体上涨 3.57%

上周（2021/10/11-2021/10/15）市场整体上涨，沪深 300 指数上涨 0.04%，上证综指下跌 0.55%，深证成指上涨 0.01%，创业板指数上涨 1.02%，中信电子下跌 0.28%，半导体指数上涨 3.57%。其中：半导体设计-0.1%、半导体制造-1.3%、半导体封测 4.9%、半导体材料 0.7%、半导体设备 0.8%、功率半导体 7.3%。

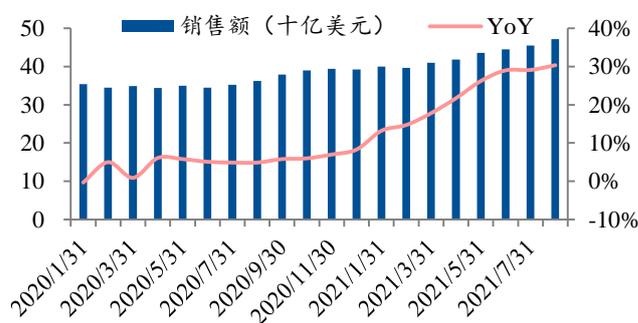
上周费城半导体指数上涨，涨幅为 2.10%，2021/1/1-2021/10/15 涨幅为 18.56%。台湾半导体指数上周上涨 2.54%，2021/1/1-2021/10/15 涨幅为 14.76%。

图 1：费城半导体指数持续上涨



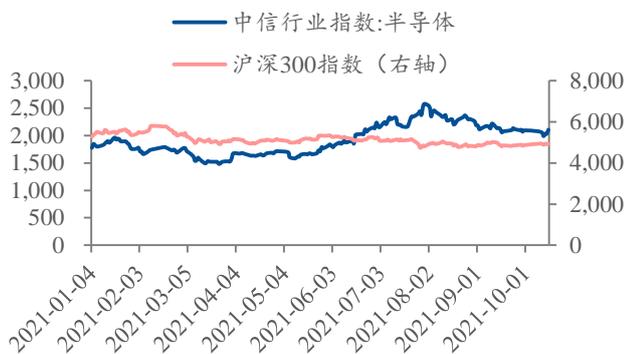
资料来源：wind，民生证券研究院

图 2：全球半导体月度销售额及增速



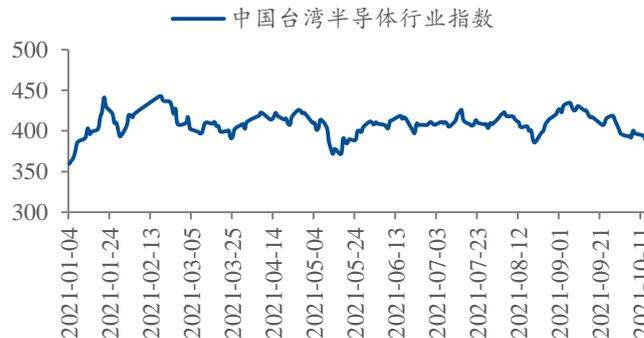
资料来源：wind，民生证券研究院

图 3：A 股半导体指数



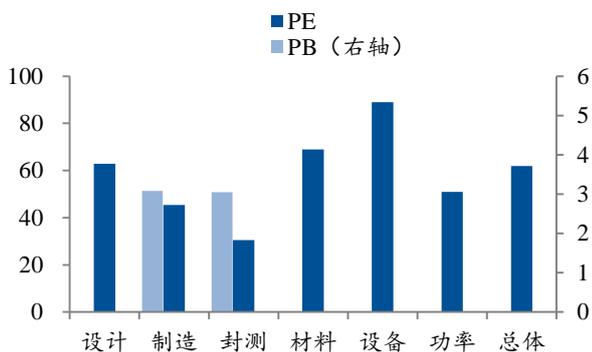
资料来源：wind，民生证券研究院

图 4：台湾半导体指数



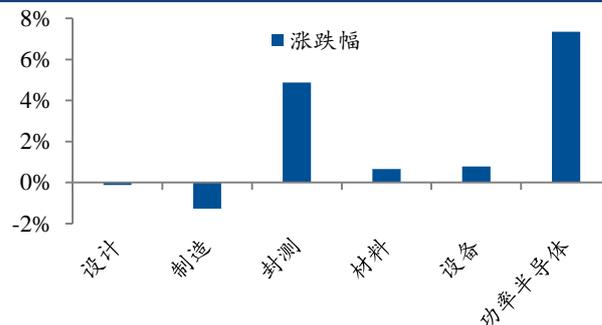
资料来源：wind，民生证券研究院

图 5: 2021-10-15 细分板块估值情况



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 6: 上周半导体各细分板块涨跌幅情况



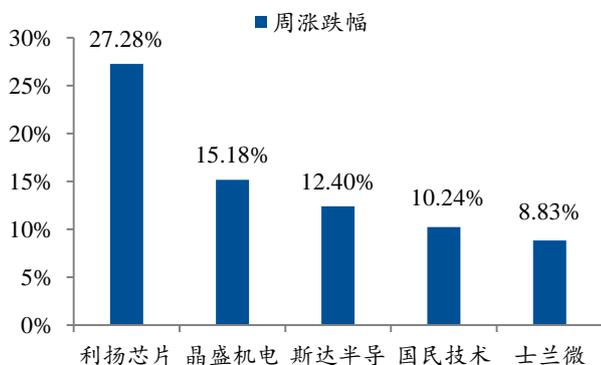
资料来源: wind, 民生证券研究院

注: PE=最近市值/2021 年 wind 一致预期净利润

注: PB=最近市值/2021 年 wind 一致预期净资产

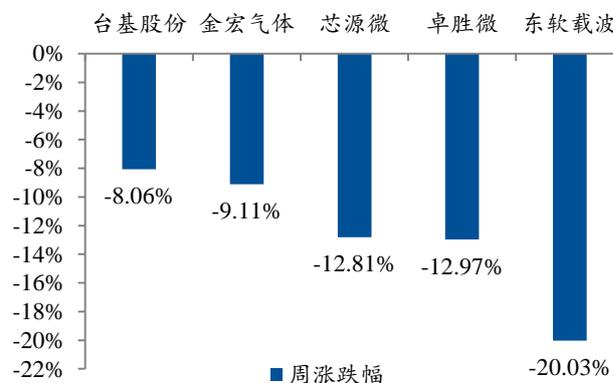
上周 (2021/10/11-2021/10/15) 半导体行业涨幅前五公司为利扬芯片 (+27.28%)、晶盛机电 (+15.18%)、斯达半导 (+12.40%)、国民技术 (+10.24%) 和士兰微 (+8.83%)，涨幅后五的公司为台基股份 (-8.06%)、金宏气体 (-9.11%)、芯源微 (-12.81%)、卓胜微 (-12.97%) 和东软载波 (-20.03%)。

图 7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司



资料来源: wind, 民生证券研究院

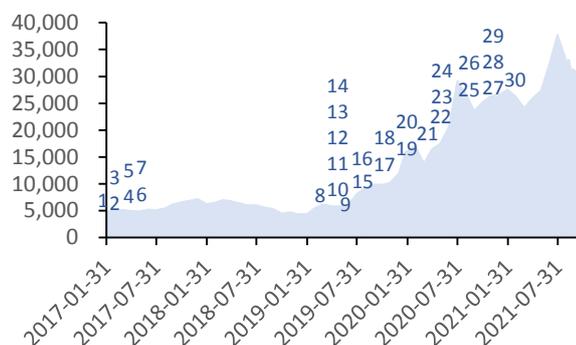
图 8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司



资料来源: wind, 民生证券研究院

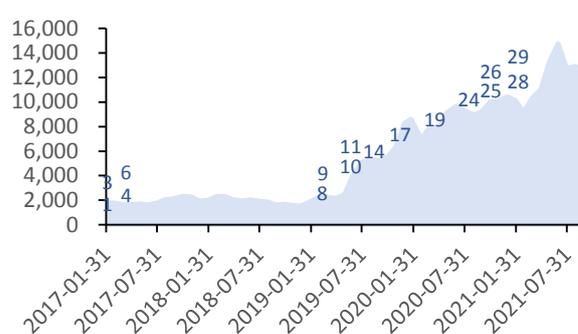
截至上周 (2021/10/15), A 股半导体公司总市值达 31,161 亿元, 环比+0.8%。其中: 设计板块公司总市值 12,166 亿元, 环比+0.5%; 制造板块公司总市值 7,564 亿元, 环比-1.1%; 设备板块公司总市值 5,146 亿元, 环比+2.1%; 材料板块公司总市值 4,410 亿元, 环比+1.8%; 封测公司总市值 1,876 亿元, 环比+4.3%。

图 9: A 股半导体板块公司总市值 (十亿元)



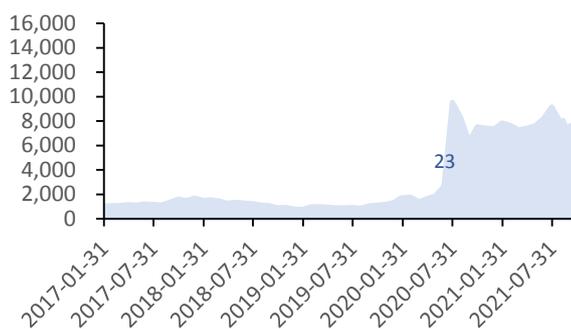
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 10: A 股半导体设计板块公司总市值 (十亿元)



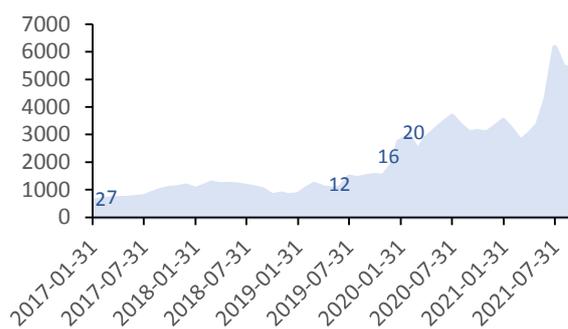
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 11: A 股半导体制造板块公司总市值 (十亿元)



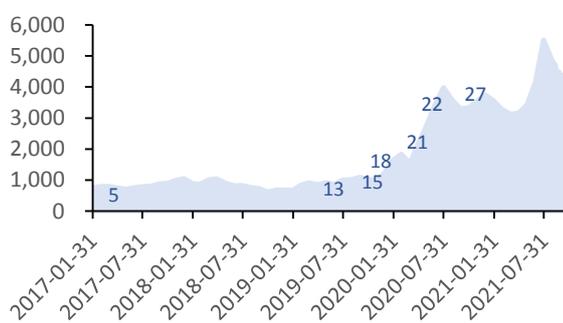
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 12: A 股半导体设备板块公司总市值 (十亿元)



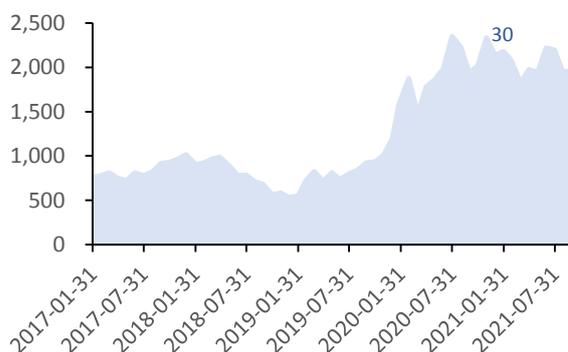
资料来源: wind, 民生证券研究院

图 13: A 股半导体材料板块公司总市值 (十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院

图 14: A 股半导体封测板块公司总市值 (十亿元)



资料来源: wind, 民生证券研究院

注 1: 2017/2/20 富瀚微 (300613.SZ) 上市 (影响当月市值 63 亿)
 注 2: 2017/4/17 长传科技 (300604.SZ) 上市 (影响当月市值 26 亿)
 注 3: 2017/5/4 韦尔股份 (603501.SH) 上市 (影响当月市值 95 亿)
 注 4: 2017/6/6 圣邦股份 (300661.SZ) 上市 (影响当月市值 44 亿)
 注 5: 2017/6/15 江丰电子 (300666.SZ) 上市 (影响当月市值 42 亿)

- 注 6: 2017/7/12 国科微 (300672.SZ) 上市 (影响当月市值 32 亿)
- 注 7: 2017/7/28 中科信息 (300678.SZ) 上市 (影响当月市值 12 亿)
- 注 8: 2019/4/15 博通集成 (603068.SH) 上市 (影响当月市值 69 亿)
- 注 9: 2019/6/18 卓胜微 (300782.SZ) 上市 (影响当月市值 111 亿)
- 注 10: 2019/7/22 乐鑫科技 (688018.SH) 上市 (影响当月市值 132 亿)
- 注 11: 2019/7/22 澜起科技 (688008.SH) 上市 (影响当月市值 874 亿)
- 注 12: 2019/7/22 中微公司 (688012.SH) 上市 (影响当月市值 473 亿)
- 注 13: 2019/7/22 安集科技 (688019.SH) 上市 (影响当月市值 103 亿)
- 注 14: 2019/8/8 晶晨股份 (688099.SH) 上市 (影响当月市值 358 亿)
- 注 15: 2019/11/20 清溢光电 (688138.SH) 上市 (影响当月市值 41 亿)
- 注 16: 2019/12/16 芯源微 (688012.SH) 上市 (影响当月市值 62 亿)
- 注 17: 2019/12/23 聚辰股份 (688123.SH) 上市 (影响当月市值 87 亿)
- 注 18: 2019/12/26 华特气体 (688268.SH) 上市 (影响当月市值 53 亿)
- 注 19: 2020/2/7 瑞芯微 (603893.SH) 上市 (影响当月市值 240 亿)
- 注 20: 2020/2/18 华峰测控 (688200.SH) 上市 (影响当月市值 155 亿)
- 注 21: 2020/4/20 沪硅产业-U (688126.SH) 上市 (影响当月市值 398 亿)
- 注 22: 2020/6/16 金宏气体 (688106.SH) 上市 (影响当月市值 262 亿)
- 注 23: 2020/7/16 中芯国际 (688981.SH) 上市 (影响当月市值 6115 亿)
- 注 24: 2020/7/22 芯朋微 (688508.SH) 上市 (影响当月市值 176 亿)
- 注 25: 2020/8/10 敏芯股份 (688286.SH) 上市 (影响当月市值 72 亿)
- 注 26: 2020/8/18 芯原股份-U (688521.SH) 上市 (影响当月市值 560 亿)
- 注 27: 2020/9/11 立昂微 (688126.SH) 上市 (影响当月市值 393 亿)
- 注 28: 2020/9/21 思瑞浦 (688536.SH) 上市 (影响当月市值 203 亿)
- 注 29: 2020/9/28 芯海科技 (688595.SH) 上市 (影响当月市值 62 亿)
- 注 30: 2020/11/11 利扬芯片 (688135.SH) 上市 (影响当月市值 78 亿)

上周 (2021/10/11-2021/10/15) 沪/深股通总体增持半导体板块。沪/深股通持股市值前 20 的企业中, 13 家企业获增持, 7 家企业被减持。增持金额前三公司为紫光国微 (6.2 亿元)、斯达半导 (3.9 亿元)、士兰微 (3.7 亿元), 减持金额前三公司为韦尔股份 (-10.2 亿元)、卓胜微 (-4.8 亿元)、大族激光 (-1.3 亿元)。

图 15、沪/深股通半导体板块持仓情况 (按持股市值排名)

本周排名	上周排名	证券代码	证券简称	一周增减持金额 (百万元)	一月增减持金额 (百万元)	年初至今增减持金额 (百万元)	沪(深)股通持股市值 (百万元)	沪(深)股通持股占自 由流通股比例 %
1	1	603501.SH	韦尔股份	-1,022	-1,507	5,770	15,085	12
2	2	002371.SZ	北方华创	61	-572	1,058	8,264	11
3	4	603986.SH	兆易创新	-75	197	4,129	7,172	10
4	3	300782.SZ	卓胜微	-481	-704	8,937	6,400	10
5	5	002008.SZ	大族激光	-128	-272	-221	5,671	18
6	6	002129.SZ	中环股份	136	-483	1,328	5,301	5
7	7	600745.SH	闻泰科技	-66	-50	2,255	4,565	7
8	8	300316.SZ	晶晨股份	-6	-160	2,489	4,551	12
9	9	300661.SZ	圣邦股份	257	449	2,277	4,451	12
10	10	600703.SH	三安光电	66	-277	313	3,825	5
11	11	002049.SZ	紫光国微	615	436	1,852	3,589	4
12	12	603290.SH	斯达半导	394	1,034		3,111	15
13	15	600460.SH	士兰微	367	537	635	1,983	4
14	13	688012.SH	中微公司	67	442		1,629	4
15	14	688008.SH	澜起科技	22	-4		1,587	6
16	17	600584.SH	长电科技	36	27	1,445	1,403	4
17	19	300327.SZ	中颖电子	45	-55	825	1,359	9
18	16	300223.SZ	北京君正	-18	377	999	1,273	6
19	18	300458.SZ	全志科技	50	127	767	1,252	9
20	20	603160.SH	汇顶科技	33	-14	-48	1,144	5

注: 此表中沪(深)股通持股市值=沪(深)股通持股数量*上周交易均价, 数据更新截止于 2021/10/15;

资料来源: wind, 民生证券研究院

2 行业新闻

1) 景气持续 大厂卡位 12 寸硅片

近日，半导体硅片厂环球晶现货订单持续涌入，一路排到明年上半年，6 吋、8 吋与 12 吋产能全线满载，长约订单比重逼近前波景气高峰（2017~2018 年）。

环球晶在手订单金额估计超两百亿，部分是 3 年长约。除环球晶外，近来包括日本信越（Shin-Etsu）、日本胜高（SUMCO）等硅片大厂，同声看好产业供不应求情况将延续至 2023 年，而胜高也与客户签订了 5 年长约。根据沪硅产业数据，目前 8 吋硅片产能缺口为 30 万/月~50 万片/月，12 吋硅片的缺口更甚。下游厂商通过签订长单锁定硅片产能，保障硅片的稳定供给，沪硅产业的硅片订单已排到 2023 年底。

这一背景下，半导体硅片供应商也在积极扩产。9 月底，胜高宣布了一项扩产计划，胜高表示，由于全球 12 吋硅片的需求持续稳定增长，其现有 12 吋先进硅片产能已跟不上需求的增长，所以胜高决定斥资 2287 亿日元（约合 134.38 亿元人民币）扩建 12 吋硅片产能。其中 2015 亿日元投资在日本佐贺县现有设施旁边的新工厂，建筑施工和设备安装将于 2022 年开始，该工厂计划从 2023 年下半年开始分阶段上线，2025 年全面投产。剩余的 272 亿日元将用于扩建由其子公司运营的工厂。目前全球半导体硅片市场最主流的产品规格为 12 吋硅片和 8 吋硅片，其中 12 吋硅片占比持续上升。

新闻链接：<https://wantrich.chinatimes.com/news/20211012S503157>

2) 中基国威拟斥资 3210.75 万元收购爱矽半导体 100% 股权

10 月 14 日，中基国威拟收购爱矽半导体 100% 股权，价格为 3210.75 万元，交易不构成重大资产重组。根据公告，有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。截至 2020 年 12 月 31 日，爱矽半导体未经审计的总资产为 1435.99 万元，负债总额为 1086.70 万元，应收账款总额 0 元、或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁）0 元、净资产为 349.28 万元，营业收入为 819.33 万元，净利润为 -167.49 万元。

新闻链接：<https://www.dramx.com/News/IC/20211015-29665.html>

3) 马来疫情终出现转机，车芯供给现曙光

10 日，马来西亚宣布，国内成人新冠疫苗接种率已达九成，将进一步放宽防疫限制。即使病例数量上升，也不会再次实施全国性封锁。据摩根士丹利对晶圆厂设备商调查显示，9 月末平均产能利用率已达 89%——8 月末仅为 51%。

安森美、恩智浦、德州仪器、意法半导体等公司的当地工厂运营均出现明显改善。根据当地政策，只要工厂员工完成接种 2 剂疫苗，工厂便可恢复 100% 产能。此前特斯拉、宝马、蔚来等车厂减产、延迟交付，主要原因都是“缺芯”。其根源便是疫情下马来当地封测厂停工/减产。全球 14% 的封测厂都位于大马，而 9 月上半月，当地工厂平均只有 47% 的人力保持运作。台积电在法说会上透露，目前车用芯片短缺问题已有所缓解，传导至 OEM 厂仍需数季度时间。

新闻链接: <https://www.dramx.com/News/automotive-electronics/20211015-29663.html>

4) 法国公布 60 亿欧元投资计划, 应对半导体短缺

法国总统马克龙 12 日公布了一项 300 亿欧元的投资计划, 主要涉及半导体、生物制药、核能、电动汽车、农业等领域, 旨在提高法国通过创新实现经济增长的能力。法国将投资近 60 亿欧元, 应对半导体短缺并确保法国工业在该领域的独立性, 使法国电子产品产量在 2030 年前增加一倍。

新闻链接: <https://www.dramx.com/News/IC/20211014-29652.html>

5) 同兴达携手日月光合作, 剑指高端封测领域

14 日, 同兴达发布公告称, 拟与昆山日月光分别出资, 合作“芯片金凸块 (Gold Bump) 全流程封装测试项目”, 从而在中国大陆建立卓越先进的高端封装技术的 Gold Bump 封测公司, 项目一期将建成月产能 2 万片 12 寸全流程 Gold Bump (金凸块) 生产工厂。为此, 同兴达拟在昆山投资设立全资子公司昆山同兴达半导体有限责任公司, 注册资金为 7.5 亿元。同兴达表示, 有助于公司向产业链前端领域延伸布局, 加强与上游芯片企业联系, 一定程度保障模组业务的芯片供应, 同时可降低部分采购成本, 增强公司盈利能力。

新闻链接: <https://www.dramx.com/News/made-sealing/20211015-29657.html>

3 三季报披露情况

3.1 设计

1) 国民技术：扣非成功扭亏为盈，存货高增体现 MCU 订单快速增长

Q3 单季扣非归母近 5 千万，业绩拐点明确——

1. Q3 单季：实现营收 3.3 亿元，同比+209%；毛利率 52%，同比+4.6pct；归母净利润 0.48 亿元，同比+86%；扣非归母 0.43，同比+348%；股份支付费用 0.41 亿元，剔除该项后扣非归母 0.85 亿元，同比+584%。业绩增长主要系通用 MCU 和负极材料及加工业务快速增长。

2. 前三季度：实现营收 6.1 亿元，同比+121%；归母净利润 0.91 亿元，同比+1513%；扣非归母 0.02 亿元，同比+103%。

MCU：订单快速增长，保守估计在手订单 3 亿元——

1. 快速成长的 MCU 新星，2018 年转型切入、2020 年实现营收，目前产品基于 ARM Cortex M0/M4 内核，料号已达 80 余种，为国内领先水平。正在研发高性能的 M7 核内产品，未来将实现 32 位 MCU 低中高端全覆盖。

2. 下游产品：主要应用于消费电子领域，少量用于工业领域，供货华为（TWS 耳机）、石头科技、荣耀、大疆（手持云台）、宁德时代（BMS）等行业龙头。

3. 21Q3 库存较 2020 年底增加 1 亿至 2.8 亿元，增长 55%，主要是公司 MCU 订单大幅增长，备货增加，多数存货处于在产品状态。按保守估计 50%为 MCU、毛利率参考同业水平按 40%-50% 计算，在手订单对应营收 2.3-2.8 亿元，生产周期约 4-6 个月，预计 21Q4、22H1 释放完成。

4. 对台积电预付订单锁定未来高增长：公司于 2020.8.7-2021.8.6 与台积电签订了多份《采购订单》，累计人民币 2.26 亿元，本次采购更多应为 MCU 产能，保守假设占 70%，对应 1.58 亿元。若不考虑 H2 涨价，1.58 亿元晶圆采购对应营收超 7 亿元，预计 MCU 营收逐季增加，今明两年释放完成。

新能源负极材料：单价上升+产能释放带动收入增长——

1. 子公司斯诺石墨化代加工订单增加、单价上升，带来业绩增长。

2. 公司内蒙古生产基地经过前期磨合，21H1 起增加除石墨化以外各生产环节代加工业务。内蒙石墨化二期也已正式试产。

向董事长定增 9-12 亿，“少数关键”人物确定坚定转型——

1. 7月12日，公司公告拟向公司董事长兼总经理孙迎彤定增9-12亿元，发行价为12.93元/股，发行完成后孙迎彤持股比例13.84-16.74%，成为公司实控人，而此前公司长期处于无实控人状态。

2. 董事长于2018年上任，带领公司用三年时间完成转型，此次“少数关键”人的确定，将助力公司向MCU转型。

2) 中颖电子：AMOLED显示驱动+电源管理高增，Q3单季度业绩翻倍

Q3单季度增幅远高于Q1、Q2。前三季度公司归母净利润2.63-2.71亿元，同比75%-80%，中值2.67亿元，同比+77%，其中非经常性损益965万元，去年同期1222万元。Q3单季度归母净利润1.10-1.18亿元，同比增加96%-109%，区间中值1.14亿元，同比+102%。其中前三季度研发费用加计扣除减少所得税额1101万元，往年于Q4确认，扣除此影响，Q3单季度业绩同比+83%。2021Q1、Q2归母净利润分别为0.68/0.85亿元，同比+61%/64%，业绩增幅逐季增加，全年高增确定性强。前三季度受益售价提升及产品组合变动，毛利率同比略有提升。

锂电池管理芯片销售翻倍，国产替代加速。锂电池管理芯片设计产品安全性高，技术壁垒高，公司产品直接对标全球龙头TI，受益贸易摩擦国产替代加速，公司业务迅速起量。在手机及TWS耳机领域已在国内多家品牌大厂量产，在笔记本电脑领域也已得到大厂的任何和采用。产品已从后装切入前装市场。动力锂电池管理芯片也将享受电动自行车、扫地机器人、电动工具等增长。

MCU稳健增长，开拓汽车高端领域。公司深耕家电MCU市场多年，在小家电市场具备明显优势，在大家电市场，贸易摩擦背景下国产替代需求强烈，份额有望持续提升。在汽车领域，公司已长期储备技术，现聚焦车身控制MCU产品，有望于年底或明年H1推向市场。

AMOLED显示驱动芯片销售同比增长数倍，计划年底推出前装产品。AMOLED显示驱动芯片市场主要由韩系和台系厂商主导，公司掌握核心技术，现主要与台厂竞争，受益贸易摩擦、手机屏需求成长趋势明确，叠加大陆主要AMOLED供应商良率改善，驱动芯片需求提升，公司销售快速提升，目前计划年底推出前装市场要求产品。

投资建议：因AMOLED显示驱动及电源管理芯片业务发展超预期，我们上调业绩，预计21-23归母净利润分别为4.0/6.0/7.4亿元(此前为3.5/5.3/6.8亿)，对应PE估值分别为46/31/25倍，参考SW半导体2021/10/12 wind一致预期PE(2021)61倍，维持“推荐”评级。

风险提示：客户开拓不及预期，产能释放不及预期。

3) 卓胜微

1. Q3 单季：预计实现净利润 4.8-5.2 亿元，同比+33-34%。
2. 前三季度：预计实现净利润 14.7-15.4 亿元，同比+105-115%。

4) 韦尔股份

1. 前三季度：预计实现净利润 32.5-36.5 亿元，同比+88.32-111.49%；扣非净利润 28.1-32.1 亿元，同比+77.52-102.74%。

业绩预增主要原因为：1) 持续优化市场布局、深耕主营业务：丰富产品、加大研发以及业务体系和产品线的整合。协同效应下持续盈利能力显著提升。2) 非经常性损益增加：处置子公司所得投资收益以及产业链上下游投资的公允价值变动损益的综合影响。

5) 圣邦股份

预计前三季度归母净利润 4.2 亿元—4.6 亿元，同比+105.03%-122.35%。Q3 单季度归母净利润 1.6 亿元—2.0 亿元，同比+60%—95%。

业绩预增主要原因为：公司积极拓展业务，产品销量增加。

3.2 设备

1) 晶盛机电

预计前三季度归母净利润 10.7 亿元 - 11.8 亿元，同比+105% - 125%；Q3 单季度归母净利润 4.7-5.8 亿元，同比增长 91%-134%。

业绩预增主要原因为：受益于光伏行业下游硅片厂商积极推进扩产进度，公司积极把握市场机遇，持续提升设备交付能力和质量管理，强化技术服务品质，实现订单量、营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。同时，公司半导体设备业务和蓝宝石材料业务也取得快速发展，为公司经营业绩增长作出积极贡献。

3.3 封测

1) 通富微电

1. Q3 单季：预计实现净利润 2.8-3.2 亿元，同比+85.66-112.26%。
2. 前三季度：预计实现净利润 6.8-7.2 亿元，同比+159.73-175.01%。

业绩预增主要原因为全球智能化加速发展等因素，国内外订单需求旺盛，公司业务持续扩大，营收规模和经营业绩保持增长趋势。

3.4 材料

1) 天华超净

1. Q3 单季：预计实现营收 8.91 亿元，同比增长 1194.96%；实现归母净利润 2.38 亿元，同比增长 464.56%。

2. 前三季度：预计实现营收 23.22 亿元，同比增长 118.26%；实现归母净利润 5.50 亿元，同比增长 139.51%。

2) 立昂微

1. Q3 单季：预计实现归母净利润 1.63-2.02 亿元，同比增长 195.22%-268.09%。

2. 前三季度：预计实现归母净利润 3.72-4.11 亿元，同比增长 184.48%-214.42%。

业绩预增主要原因为：1) 公司之前较早布局且完成了 6 英寸、8 英寸硅片新产线建设，实施了功率器件芯片制造产线的产能技改提升，目前各生产线满负荷运转，销售订单饱满，主要产品产销量大幅提升。2) 12 英寸硅片的功率器件及图像传感器件覆盖客户所需技术节点且已大规模出货，8 英寸硅片产销量进一步放大。3) 公司通过管理提升和精益化生产，在技术改进、良率提升和成本费用控制节约等方面成果显著。

3) 康强电子

1. Q3 单季：预计实现归母净利润 0.39-0.59 亿元，同比增长 97.12%-198.27%。

2. 前三季度：预计实现归母净利润 1.10-1.30 亿元，同比增长 53.58%-81.50%。

业绩预增主要原因为：1) 今年半导体行业景气度高，下游客户需求增加，公司部分产品供不应求，产销两旺。2) 蚀刻引线框架产品的市场需求增长显著，使得业绩同比增长较多。3) 公司通过加强内部管理、优化资源配置，减少原材料涨价等负面影响。

4) 中晶科技

1. Q3 单季：预计实现归母净利润 0.40-0.45 亿元，同比增长 69.44%-90.62%。

2. 前三季度：预计实现归母净利润 1.10-1.20 亿元，同比增长 77.86%-94.03%。

业绩预增主要原因为：1) 国内半导体行业景气度较高，公司产品市场需求旺盛，浙江公司硅片扩产以及宁夏公司晶棒扩产项目顺利。2) 公司加大研发投入，通过工艺技术改造、设备自动化改造等方式，提高生产效率及质量水平，增强了公司产品的盈利能力。

5) 飞凯材料

1. Q3 单季：预计实现归母净利润 0.70-1.04 亿元，同比增长 17.23%-74.41%。

2. 前三季度：预计实现归母净利润 2.38-2.72 亿元，同比增长 40%-60%。

业绩预增主要原因为：1) 屏幕显示材料受益于国产化率持续提升、正性光刻胶业务的大幅增长以及新产品负性光刻胶开始形成销售，本报告期营业收入实现较大增长。2) 半导体材料受到下游需求增加的影响，本报告期营业收入增长较大。3) 紫外固化材料受到下游需求增长，以及塑胶表面处理型功能材料业务拓展的影响，本报告期营业收入实现一定增长。4) 有机合成医药中间体产品近期受到下游新需求的影响，本报告期营业收入实现大幅增长。

6) 上海新阳

1. Q3 单季：预计实现归母净利润 (-0.18) 至 (-0.25) 亿元，同比减少 119.92%-116.56%；扣非归母净利润 0.30-0.38 亿元，同比增长 102.54% - 156.55%。

2. 前三季度：预计实现归母净利润 0.83-0.90 亿元，同比减少 49.12%-53.07%。

业绩变动主要原因为：1) 公司营业收入继续保持大幅增长，半导体和涂料业务销售收入均实现了 50% 左右的增长。2) 由于公司开展光刻胶项目和参与国家重大科技项目，研发投入持续加大，研发费用增加明显。3) Q3 交易性金融资产的公允价值变动导致公司归母净利润减少约 5800 万元。

3.5 功率

1) 苏州固得

1. Q3 单季：预计实现归母净利润 0.69-0.80 亿元，同比增长 147.98%-187.13%。

2. 前三季度：预计实现归母净利润 1.78-2.07 亿元，同比增长 140%-177%。

业绩预增主要原因为：1) 功率半导体国产替代加速，公司半导体产品产销两旺，同时，公司扩产的产能逐步释放，公司合并营业收入同比增长超过 50%。2) 集成电路和 PPAK 封装、MEMS 封测增长较快，销售额和销售量创新高。3) 公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司在单晶 PERC 银浆性能上取得突破，销售额同比增长；同时公司 2020 年底完成的收购该公司少数股权事项，子公司晶银股权占比由 2020 年的 54.8% 变为 100%，增加利润。4) 预计非经常性损益对归母净利润的影响金额为 2000 万元——2500 万元。

2) 扬杰科技

1. Q3 单季：预计实现营收 11.61 亿元，同比增长 64.24%；实现归母净利润 2.20 亿元，同比增长 86.59%。

2. 前三季度：预计实现营收 32.41 亿元，同比增长 75.76%；实现归母净利润 5.65 亿元，同比增长 115.17%。

业绩增长主要原因为：1) 2021 年经济复苏，功率半导体国产替代加速，半导体行业景气度高，公司抓住机遇，积极扩大市场份额，实现满产满销。2) 公司前期整合研发团队，加大研发投入，积极推进重点研发项目的管理实施，加快新产品的研发速度，促使新产品释放效益，新产品业绩突出。MOS、小信号、IGBT 及模块等产品的业绩同比增长均在 100%以上。

3) 捷捷微电

1. Q3 单季：预计实现归母净利润 1.39-1.58 亿元，同比增长 80%-105%。

2. 前三季度：预计实现归母净利润 3.68-4.07 亿元，同比增长 90%-110%。

业绩预增主要原因为：1) 公司报告期主营业务收入较上年同期有较大幅度的增长，其中：MOS、小信号系列产品同比增长超 170%，可控硅业务同比增长 73.7%。2) 公司继续加大研发投入，继续完善符合产业发展的平台建设与人才引进机制，促进产品结构升级和优化。3) 非经常性损益对归属于公司股东的归母净利润影响额约为 2550 万元。

4 本周重点报告：雅克科技——稀缺与成长兼备，半导体材料平台龙头正起航

本周（2021/10/11）我们发布雅克科技深度报告：前瞻战略眼光&优秀管理能力并举，成为国内半导体材料平台龙头。公司以阻燃剂起家，通过收购 UP 化学/LG 化学资产/科特美/科美特/华飞电子，切入 SOD&前驱体/面板彩胶/面板正胶/电子特气/硅微粉领域，已成国内电子材料平台龙头。1) 前驱体&SOD。行业β：晶圆厂密集扩产，需求量价齐升。公司α：聚焦半导体卡脖子关键材料领域，具备高度稀缺性。与全球龙头客户开发最先进制程产品，确保代际领先与显著成本优势。2) 面板光刻胶：全球面板产能向大陆转移，公司与全球龙头客户开发先进产品，技术实力领先。全球彩胶第二大龙头 JSR 于今年 9 月结束在中国台湾及韩国业务，公司有望承接 JSR 退出份额。定增扩产与国产替代加速，增厚业绩发展。3) 电子特气：已打入国际龙头客户，积极扩产巩固领先地位。4) 硅微粉：技术实力比肩国外先进水平，产能扩张&产品升级助力业绩增长。5) LNG 保温材料：打破韩国 LNG 保温绝热材料垄断，在手订单充沛收入大幅增长。预计 2021-2023 年公司归母净利分别为 6.07/8.48/12.35 亿元，同增 47.0%/39.7%/45.6%，对应 PE 分别为 60/43/29 倍。

风险提示：研发进展不及预期，扩产进度不及预期，下游需求不及预期，客户拓展不及预期。

5 投资建议

持续推荐半导体行业具有大空间/高景气度板块领先企业：

- 1) 设计：看好景气持续下价格持续上涨的弹性标的，建议关注韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、中颖电子、恒玄科技、芯海科技、圣邦股份、思瑞浦、乐鑫科技、汇顶科技等；
- 2) 功率：产能紧张&涨价持续，高景气趋势仍将持续。建议关注斯达半导、士兰微、中车时代电气、华润微、扬杰科技、新洁能、闻泰科技、捷捷微电等；
- 3) 设备：景气持续下代工厂/封测厂扩产+国产替代下国内存储厂扩产，建议关注北方华创、芯源微、华峰测控、中微公司、芯基微装等；
- 4) 材料：建议关注雅克科技、安集科技、鼎龙股份、江丰电子、华特气体、金宏气体等；
- 5) 代工：产能持续满载+国产替代，建议关注中芯国际、华虹半导体；
- 6) 封测：产能持续满载，建议关注长电科技、通富微电、深科技、华天科技等。

盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价 10月15日	EPS			PE			评级
			2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	
603501.SH	韦尔股份	250	3.11	5.19	7.36	80	48	34	推荐
603986.SH	兆易创新	156	1.32	2.92	4.21	118	53	37	推荐
300782.SZ	卓胜微	312	3.22	6.51	8.70	97	48	36	推荐
300671.SZ	富满电子	89	0.49	4.85	7.08	181	18	13	推荐
688608.SH	恒玄科技	266	1.65	4.33	5.82	161	61	46	推荐
688595.SH	芯海科技	95	0.89	1.12	2.26	106	84	42	推荐
300661.SZ	圣邦股份	343	1.23	2.27	3.06	279	151	112	NA
688536.SH	思瑞浦	641	2.30	4.25	6.33	279	151	101	NA
688018.SH	乐鑫科技	194	1.30	3.53	4.86	149	55	40	推荐
603160.SH	汇顶科技	108	3.62	2.48	3.40	30	44	32	推荐
600460.SH	士兰微	61	0.05	0.67	0.86	1286	91	71	推荐
688396.SH	华润微	72	0.73	1.88	2.19	99	38	33	推荐
300373.SZ	扬杰科技	51	0.74	1.33	1.65	69	38	31	NA
603290.SH	斯达半导	413	1.13	2.18	3.03	366	190	136	推荐
605111.SH	新洁能	134	0.98	2.78	3.25	136	48	41	推荐
3898.HK	中车时代电气	37	2.08	2.20	2.50	18	17	15	NA
600745.SH	闻泰科技	99	1.94	2.68	3.64	51	37	27	推荐
300623.SZ	捷捷微电	33	0.38	0.68	0.87	86	49	38	NA
002371.SZ	北方华创	354	1.08	1.68	2.40	328	210	148	NA
688200.SH	华峰测控	536	3.25	6.70	9.67	165	80	55	推荐
688012.SH	中微公司	154	0.80	0.90	1.15	193	171	134	推荐
688037.SH	芯源微	203	0.58	1.10	1.99	350	186	102	推荐
688630.SH	芯基微装	55	0.59	0.92	1.27	94	60	44	推荐
002409.SZ	雅克科技	75	0.87	1.28	1.72	86	59	43	推荐
688019.SH	安集科技	229	2.89	2.87	3.95	79	80	58	NA
300666.SZ	江丰电子	44	0.65	0.76	1.00	68	58	44	NA

603650.SH	彤程新材	49	0.69	0.85	1.09	71	58	45	推荐
688268.SH	华特气体	78	0.89	1.28	1.70	88	61	46	推荐
688106.SH	金宏气体	23	0.41	0.53	0.66	56	43	34	推荐
300054.SZ	鼎龙股份	19	-0.17	0.32	0.45	NA	61	43	NA
688981.SH	中芯国际	55	0.55	1.32	1.46	100	42	38	推荐
1347.HK	华虹半导体	39	0.59	0.98	1.22	65	40	32	NA
600584.SH	长电科技	33	0.73	1.29	1.54	45	26	22	NA
002156.SZ	通富微电	20	0.25	0.64	0.89	80	32	23	推荐
000021.SZ	深科技	15	0.55	0.54	0.67	27	27	22	推荐

资料来源：Wind、民生证券研究院

注：韦尔股份、兆易创新、卓胜微、富满电子、恒玄科技、芯海科技、乐鑫科技、汇顶科技、士兰微、华润微、斯达半导、新洁能、闻泰科技、华峰测控、中微公司、芯源微、芯基微装、雅克科技、彤程新材、华特气体、金宏气体、中芯国际、通富微电、深科技采用民生证券预测值，其他公司采用wind一致预期。

6 风险提示

下游代工厂扩产进度可能不及预期、国内厂商先进技术发展可能不及预期、行业景气度持续不及预期。

插图目录

图 1: 费城半导体指数持续上涨.....	3
图 2: 全球半导体月度销售额及增速.....	3
图 3: 股半导体指数.....	3
图 4: 台湾半导体指数.....	3
图 5: 2021-10-15 细分板块估值情况.....	4
图 6: 上周半导体各细分板块涨跌幅情况.....	4
图 7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司.....	4
图 8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司.....	4
图 9: A 股半导体板块公司总市值 (十亿元).....	5
图 10: A 股半导体设计板块公司总市值 (十亿元).....	5
图 11: A 股半导体设制造块公司总市值 (十亿元).....	5
图 12: A 股半导体设备板块公司总市值 (十亿元).....	5
图 13: A 股半导体材料板块公司总市值 (十亿元).....	5
图 14: A 股半导体封测板块公司总市值 (十亿元).....	5
图 15、沪/深股通半导体板块持仓情况 (按持股市值排名).....	6

分析师与研究助理简介

王芳，电子行业首席，曾供职于东方证券股份有限公司、一级市场私募股权投资有限公司，获得中国科学技术大学理学学士，上海交通大学上海高级金融学院硕士。

杨旭，电子行业分析师，曾供职于东方证券股份有限公司，复旦大学理学博士。

王浩然，电子行业分析师，曾任职于东吴证券股份有限公司，2019年新财富环保行业第三名团队核心成员，获上海财经大学理学学士、金融硕士。

赵晗泥，电子行业研究助理，2020年加入民生电子，曾就职于外资行业研究，爱丁堡大学经济学硕士，复旦大学经济学学士。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的12个月内公司股价的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来股价涨幅15%以上
	谨慎推荐	分析师预测未来股价涨幅5%~15%之间
	中性	分析师预测未来股价涨幅-5%~5%之间
	回避	分析师预测未来股价跌幅5%以上
行业评级标准		
以报告发布日后的12个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测未来行业指数涨幅5%以上
	中性	分析师预测未来行业指数涨幅-5%~5%之间
	回避	分析师预测未来行业指数跌幅5%以上

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路8号财富金融广场1幢5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座18层； 100005

深圳：广东省深圳市深南东路5016号京基一百大厦A座6701-01单元； 518001

免责声明

本报告仅供民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。

本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。

本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。

未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以其他方式发送、传播本报告。本公司版权所有并保留一切权利。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。